

SEMICON[®]
JAPAN

硬脆材料ウェーハ研削盤
Model DDT832

JTEKT ジェイテクトマシンシステム
JTEKT MACHINE SYSTEMS CORPORATION



出展のご案内

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社はこのたび「SEMICON JAPAN 2024」へ出展いたしますのでご案内申し上げます。

今回は、硬脆材料ウェーハ研削盤DDT832の展示を行います。

この機会に是非、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

敬具

2024年11月吉日
株式会社ジェイテクトマシンシステム
代表取締役社長 宮藤 賢士

開催概要・出展位置

会期:2024年12月11日(水)～13日(金)

開催時間:10:00～17:00

会場:東京ビッグサイト

出展位置:東2ホール 2942

共同出展:株式会社ジェイテクト、株式会社ジェイテクトグラインディングツール

JTEKT 株式会社ジェイテクトマシンシステム